

平成21年3月期
決算概要

<目 次>

	頁
平成21年3月期 決算短信	1
1. 経営成績	3
(1) 経営成績に関する分析	
(2) 財政状態に関する分析	
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	
(4) 事業等のリスク	
2. 企業集団の状況 事業系統図	13
3. 経営方針	15
(1) 会社の経営の基本方針	
(2) 目標とする経営指標	
(3) 中長期的な会社の経営戦略	
(4) 会社の対処すべき課題	
(5) 企業の社会的責任	
4. 連結財務諸表	
(1) 連結貸借対照表	18
(2) 連結損益計算書	19
(3) 連結資本勘定計算書	20
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	21
(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況	22
(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項	22
セグメント情報	23
金融商品	25
リース取引	
ストック・オプション	26
1株当たり当期純損益	
設備投資額・研究開発費	
重要な後発事象	27
<参考>四半期連結財務諸表(3か月)	
(1) 四半期連結損益計算書(3か月)	28
(2) 四半期連結資本勘定計算書(3か月)	29
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3か月)	30
(4) セグメント情報(3か月)	31
5. 個別財務諸表	
(1) 貸借対照表	33
(2) 損益計算書	36
(3) 株主資本等変動計算書	37
(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況	39
リース取引関係	39
有価証券関係	
重要な後発事象	40
<参考>平成21年3月期 連結決算概要	41

平成21年3月期 決算短信〔米国会計基準〕

平成21年5月11日
上場取引所 東上場会社名 NECエレクトロニクス株式会社
コード番号 6723 URL <http://www.necel.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中島 俊雄
問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 遠藤 泰三
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日
配当支払開始予定日 —

TEL 044-435-1664

(百万円未満四捨五入)

1. 21年3月期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前当期純利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期	546,470	△20.5	△68,355	—	△89,335	—	△82,625	—
20年3月期	687,745	△0.7	5,094	—	△3,252	—	△15,995	—

	1株当たり当期純利益	希薄化後1株当たり当期純利益	株主資本当期純利益率	総資産税引前当期純利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
21年3月期	△669.04	△669.04	△46.5	△16.3	△12.5
20年3月期	△129.52	△129.52	△6.5	△0.5	0.7

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 307百万円 20年3月期 △207百万円

注) 1. 1株当たり当期純利益は米国会計基準第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

2. 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業利益は「売上高」から「売上原価」「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期	482,545	128,130	26.6	1,037.51
20年3月期	616,304	227,138	36.9	1,839.20

(注) 株主資本の金額は、米国会計基準に基づいて表示しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年3月期	△6,933	△49,256	△4,295	101,279
20年3月期	43,262	△37,769	△22,985	165,472

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	株主資本配 当率
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
20年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
21年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—

3. 22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
第2四半期 連結累計期間	215,000	△35.5	△25,000	—	△26,500	—
通期	480,000	△12.2	0	—	△7,500	—

(注) 当社株主に帰属する当期純利益※ 第2四半期連結累計期間 △27,000百万円 通期 △9,000百万円

1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 第2四半期連結累計期間 △218円62銭 通期 △72円87銭

※「当社株主に帰属する当期純利益」は、平成21年3月期までの「当期純利益」と同じ内容です。

(注) 詳細は7ページ、(1)経営成績に関する分析 5. 次期の見通しをご覧ください。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う子会社の異動) 有

新規 一社 (社名) 除外 2社 (社名 福井日本電気株式会社、NECセミコンパッケージ・ソリューションズ株式会社)

(注)詳細は、13ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注)詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	21年3月期 123,500,000株	20年3月期 123,500,000株
② 期末自己株式数	21年3月期 2,306株	20年3月期 2,039株
③ 期中平均株式数	21年3月期 123,497,808株	20年3月期 123,498,165株

(参考)個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期	476,516	△19.1	△55,413	—	△52,102	—	△77,941	—
20年3月期	588,999	△1.2	△26,801	—	△29,505	—	△28,417	—

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期	△631.12	—
20年3月期	△230.10	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭	
21年3月期	391,604	159,843	159,843	40.8	1,293.75			
20年3月期	508,282	237,765	237,765	46.8	1,924.78			

(参考) 自己資本 21年3月期 159,775百万円 20年3月期 237,706百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、業績見通しと乖離する可能性があります。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の経済および事業環境

当連結会計年度の世界経済は、前期の後半から続いた景気の後退基調に、年度の前半は原油価格の高騰、後半は金融市場の混乱がそれぞれ一層の拍車をかけ、極めて厳しい不況に陥りました。特に昨年の秋以降には、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱が米国において大手金融機関の経営破綻という深刻な事態をもたらし、それによる経済への悪影響が米国だけでなく、住宅バブルを抱えていた欧州、さらには中国などの新興国にも急速に広がり、世界同時不況の様相を呈するに至りました。こうした中で、日本経済についても、海外の景気悪化により輸出が大幅に減少し、国内の製造や雇用の調整等が一気に進むとともに、急激な円高の進行による輸出採算の悪化が国内の製造業に大きな打撃を与えるなど、景気は大きく落ち込みました。

こうした情勢のもと、当社グループの主力事業領域である半導体市場においては、昨年夏以降、顧客である電子・電気機器業界や自動車業界が受けた急激な需要の減少に伴う在庫調整および発注抑制の影響を受け、海外では経営破綻する大手半導体企業が現れるなど、平成13年のITバブル崩壊時の半導体不況を上回る厳しい状況となりました。

② 当連結会計年度の連結業績

(単位 億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	前期比 増(減)	
売上高	6,877	5,465	△1,413	△20.5%
半導体売上高	6,533	5,217	△1,315	△20.1%
営業損益	51	△684	△734	—
税引前損益	△33	△893	△861	—
当期純損益	△160	△826	△666	—
米ドル為替レート(円)	116	101		
ユーロ為替レート(円)	161	146		

当連結会計年度の連結売上高は5,465億円と、前期と比べ1,413億円(20.5%)の減少となりました。

製品分野別でみると、すべての分野において売上高が前期と比べ減少となり、特にコンピュータおよび周辺機器分野、ディスクリート・光・マイクロ波においては、売上高が前期と比べ25%以上の大幅な減少となりました。

連結営業損益は684億円の損失で、前期と比べ734億円の悪化となりました。これは、連結売上高が前期と比べ減少したことなどによるものです。

連結税引前損益は893億円の損失で、前期と比べ861億円の悪化となりました。これは、連結営業損益が前期と比べ悪化したことに加え、係争案件に関する損失引当金を計上したこと、国内の開発試作・製造ラインを閉鎖したこと等の結果、営業外費用が増加したことなどによるものです。

連結当期純損益は826億円の損失で、前期と比べ666億円の悪化となりました。なお、当連結会計年度において、海外子会社の配当金に関する税制改正に伴い、海外子会社からの配当時に負担する税金について計上していた繰延税金負債の一部取崩しを行いました。これにより、法人税等を減額しております。

③ 製品分野別連結売上高実績

製品分野別の連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	前期比 増(減)	
通 信 機 器 分 野	704	602	△102	△14.4%
コンピュータおよび周辺機器分野	1,194	872	△321	△26.9%
民生用電子機器分野	1,345	1,193	△152	△11.3%
自動車および産業機器分野	1,133	915	△218	△19.3%
多目的・多用途 I C	896	705	△192	△21.4%
ディスクリット・光・マイクロ波	1,261	930	△331	△26.2%
半 導 体 計	6,533	5,217	△1,315	△20.1%
そ の 他	345	247	△97	△28.2%
合 計	6,877	5,465	△1,413	△20.5%

◆ 通信機器分野 売上高 602億円 (前期比14.4%減)

通信機器分野の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ102億円(14.4%)減少し、602億円となりました。

当分野には、ルータ、携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や携帯電話端末向け半導体が含まれます。

当連結会計年度は、携帯電話端末向けカメラ L S I の売上が前期と比べ増加したものの、携帯電話端末向けベースバンド L S I、L C D (液晶ディスプレイ) ドライバ I C の売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ コンピュータおよび周辺機器分野 売上高 872億円 (前期比26.9%減)

コンピュータおよび周辺機器分野の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ321億円(26.9%)減少し、872億円となりました。

当分野には、サーバおよびワークステーション向け半導体やパソコンおよびパソコン周辺機器向け半導体が含まれます。

当連結会計年度は、パソコン用モニターや液晶テレビ向け L C D ドライバ I C やプリンタ向け半導体の売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ 民生用電子機器分野 売上高 1,193億円 (前期比11.3%減)

民生用電子機器分野の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ152億円(11.3%)減少し、1,193億円となりました。

当分野には、家電製品向け半導体やゲーム機向け半導体が含まれます。

当連結会計年度は、デジタルテレビやブルーレイ・ディスク機器向け画像処理 L S I 「EMMA (エマ)」シリーズの売上が前期と比べ増加したものの、デジタルカメラ向け半導体や白物家電向け半導体の売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ 自動車および産業機器分野 売上高 915億円 (前期比19.3%減)

自動車および産業機器分野の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ218億円(19.3%)減少し、915億円となりました。

当分野には、自動車向け半導体、F A (ファクトリー・オートメーション) 機器などの産業機器向け半導体が含まれます。

当連結会計年度は、自動車向けマイクロコントローラや産業機器向け半導体の売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ 多目的・多用途 I C 売上高 705億円（前期比21.4%減）

多目的・多用途 I Cの当連結会計年度の売上高は、前期と比べ192億円(21.4%)減少し、705億円となりました。

当分野には、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途の S R A Mなどが含まれます。

当連結会計年度は、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイの売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ ディスクリート・光・マイクロ波 売上高 930億円（前期比26.2%減）

ディスクリート・光・マイクロ波の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ331億円(26.2%)減少し、930億円となりました。

当分野には、ダイオード、トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信やDVD(デジタル多用途ディスク)向け光半導体、携帯電話端末などに使用されるマイクロ波半導体が含まれます。

当連結会計年度は、ディスクリート半導体や、光半導体、マイクロ波半導体など化合物半導体の売上が前期と比べ減少いたしました。

◆ その他 売上高 247億円（前期比28.2%減）

その他の当連結会計年度の売上高は、前期と比べ97億円(28.2%)減少し、247億円となりました。

当分野には、主に当社の販売子会社が行っているLCDパネルの再販など、半導体以外の製品の販売事業が含まれます。

④ 所在地別連結売上高実績

当社あるいは当社の子会社の所在地別に分類した連結売上高は次のとおりです。

(単位 億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	前期比 増(減)	
			増(減)	増(減)
日 本	3,702	3,016	△686	△18.5%
米 国	583	386	△196	△33.7%
欧 州	959	745	△215	△22.4%
ア ジ ア	1,633	1,317	△316	△19.3%
合 計	6,877	5,465	△1,413	△20.5%

(注) 当社の子会社の所在地において、日本および米国以外の各区分に属する国は以下のとおりです。

欧州：ドイツ、英国、アイルランド

アジア：中国、インドネシア、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾

◆ 日本 売上高 3,016億円 (前期比18.5%減)

日本では、携帯電話端末向けベースバンドLSIやディスクリート半導体の売上が減少したことなどにより、当連結会計年度の売上高は、前期と比べ686億円(18.5%)減少し、3,016億円となりました。

◆ 米国 売上高 386億円 (前期比33.7%減)

米国では、汎用マイクロコントローラや携帯電話端末向けメモリの売上が減少したことなどにより、当連結会計年度の売上高は、前期と比べ196億円(33.7%)減少し、386億円となりました。

◆ 欧州 売上高 745億円 (前期比22.4%減)

欧州では、汎用マイクロコントローラや自動車向け半導体の売上が減少したことなどにより、当連結会計年度の売上高は、前期と比べ215億円(22.4%)減少し、745億円となりました。

なお、前連結会計年度および当連結会計年度の欧州における売上高に占める大部分は、ドイツに本社を置く子会社によるものであります。

◆ アジア 売上高 1,317億円 (前期比19.3%減)

アジアでは、液晶テレビやパソコン用モニタ向けLCDドライバICやディスクリート半導体の売上が減少したことなどにより、当連結会計年度の売上高は、前期と比べ316億円(19.3%)減少し、1,317億円となりました。

なお、前連結会計年度および当連結会計年度の、中国に本社を置く子会社における売上高は、それぞれ931億円、724億円であります。

⑤ 次期(平成22年3月期)の連結業績見通し

次期における半導体市場の見通しについては、昨年後半からの世界経済の景気悪化が深刻度を増す中、顧客である電子・電気機器業界や自動車業界の需要の減少はしばらく継続するものと考えており、中国市場向けなど一部製品では受注の回復がみられるなど、半導体の需要に底打ちの兆しが見られるものの、本格的な市況回復にはまだ時間を要し、当期同様、依然として厳しい状況が続くものと見込んでおります。

このような厳しい事業環境のもと、次期の連結業績見通しに関しては、売上高は当期に比べ約12%減収の4,800億円、うち、当社グループの主力事業である半導体売上高については、当社グループの強みである低消費電力技術、画像処理技術、DRAM混載技術などを活かした製品の売上拡大に努めるものの、当期に比べ約12%減収の4,600億円を見込んでおります。

営業損益については、売上高の減少による利益悪化要因があるものの、固定費の削減等、体質改善施策を行うことにより0億円を見込んでおります。具体的には、製造体制の再構築の加速、研究開発の一層の効率化、人件費の削減を含む経費の削減など、企業の生き残りをかけた体質改善を断行し、固定費を当期に比べ大幅に削減することなどにより、営業損益の黒字化を目指します。

税引前損益については、製造ラインの閉鎖による構造改革費用の発生などにより75億円の損失、当社株主に帰属する当期純損益は90億円の損失を見込んでおります。

また、当社は、平成21年4月27日に、株式会社ルネサス テクノロジとの間で、当社と同社の事業統合に向けた協議を開始することについて基本合意いたしました。本件に関して業績予想の修正が必要となった場合は、速やかに開示いたします。

(平成22年3月期の連結業績予想)

		(当期比)
売上高	4,800億円	△12.2%
(半導体売上高)	4,600億円	△11.8%
営業損益	0億円	—
税引前損益	△75億円	—
当社株主に帰属する当期純損益	△90億円	—

(注) 「当社株主に帰属する当期純損益」は平成21年3月期までの「当期純損益」と同じ内容です。

なお、通期業績見通しにあたっては、1米ドル95円、1ユーロ125円を前提としております。

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

(2) 財政状態に関する分析

① 総資産、株主資本および有利子負債の状況

(連結財政状態)

(単位 億円)

	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)	当連結会計年度末 (平成21年3月31日)	前期末比 増(減)
総資産	6,163	4,825	△1,338
株主資本	2,271	1,281	△990
株主資本比率(%)	36.9	26.6	△10.3
1株当たり株主資本(円)	1,839	1,038	△802
有利子負債	1,166	1,169	3

当連結会計年度末の総資産残高は、4,825億円で、前期末と比べ1,338億円の減少となりました。これは、売上高の減少などにより受取手形および売掛金が439億円減少したことや、設備投資の削減や減価償却などにより有形固定資産が171億円減少したことに加え、連結当期純損失を計上したことなどにより株主資本が大幅に減少したことなどによるものです。

株主資本は、1,281億円で、前期末と比べ990億円の減少となりました。これは、連結当期純損失を826億円計上したことや、主に為替相場や株式相場の影響により、その他の包括損益累計額が164億円悪化したことなどによるものです。

株主資本比率は、株主資本の減少により前期末と比べ10.3ポイント低下しました。

有利子負債は、リース負債の増加などにより、前期末と比べ3億円増加し1,169億円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

(連結キャッシュ・フローの状況)

(単位 億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増(減)
営業活動によるキャッシュ・フロー	433	△69	△502
投資活動によるキャッシュ・フロー	△378	△493	△115
フリー・キャッシュ・フロー	55	△562	△617
財務活動によるキャッシュ・フロー	△230	△43	187
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△24	△37	△13
現金および現金同等物純増加(減少)額	△199	△642	△443
現金および現金同等物期首残高	1,854	1,655	△199
現金および現金同等物期末残高	1,655	1,013	△642

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等の計上額が673億円であったものの、連結当期純損失を826億円計上したことなどにより、69億円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の購入による支払が530億円であったことなどにより、493億円の支出となりました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは562億円の支出となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により43億円の支出となりました。

以上に、為替相場の変動による現金および現金同等物の減少額37億円を考慮した、当連結会計年度における現金および現金同等物純増加(減少)額は642億円の減少となり、現金および現金同等物期末残高は1,013億円となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、企業価値の最大化の観点から、新製品の研究開発、設備投資などのために内部留保を重視し、強靱な財務体質の実現を目指しながら、利益の一部を配当してまいります。各期の配当の金額につきましては、連結および単独の利益剰余金の状況、連結の利益の状況、翌期以降の利益見通しおよびキャッシュ・フローの状況などを考慮し決定いたします。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当期(平成21年3月期)の配当につきましては、連結・単独業績とも当期純損失を計上するに至ったこと、また連結・単独とも累積損失の状況にあることから、これを見送らせていただきます。

次期(平成22年3月期)の配当につきましては、連結業績が当期純損失を計上する見込みであることから中間・期末ともこれを見送らせていただく予定であります。できるだけ早期に配当を再開すべく、業績の改善および財政状況の改善に努めてまいります。

(4) 事業等のリスク

当社グループが認識している事業等のリスクのうち、主要なものは次のとおりであります。

<当社グループの事業に関するリスクについて>

①市況の変動による影響

当社グループは、常に市況の動向を見極めながら事業活動を遂行しておりますが、世界各国の景気循環や最終製品の需要の変化などに起因する、半導体市場の循環的な市況変動の影響を完全に回避することは困難であるため、市況が下降した局面においては、当社グループの売上の減少や、工場稼働率の低下による原価率の悪化により、大幅に収益が悪化する可能性があります。

②為替の変動による影響

当社グループの経営成績および財政状態は、為替相場の変動によって影響を受けます。当社グループは、こうした為替相場の変動による影響を軽減するため、先物為替予約をはじめとした様々な対策を講じておりますが、為替相場が大きく変動した場合、外貨建製品の売上高、外貨建の資材コスト、海外工場の生産コスト等が影響を受ける可能性があります。また、当社の外貨建の資産・負債を日本円に換算表示すること、さらに、海外子会社における外貨表示の財務諸表を日本円に換算表示することによっても、当社グループの資産・負債および収益・費用は変動します。

③各国の法制度およびその運用等による影響

当社グループは、世界各国で開発、生産、販売活動を行っておりますが、その国や地域において、政情や治安が不安定になったり、貿易、雇用、環境等現地での事業展開に影響する法令や政府の方針が変更されたり、経済情勢や経済基盤が悪化する等のリスクに直面する可能性があります。

④自然災害等のリスク

地震、台風、洪水等の自然災害、事故、テロをはじめとした当社グループがコントロールできない事由によって、所有する半導体工場等の設備が壊滅的な損害を被り、その操業を停止せざるを得なくなる可能性があります。特に、当社グループは、地震が発生する確率が世界の平均より高いと考えられる地域に重要な設備を保有しており、地震の発生時には、その影響により工場等の操業を停止せざるを得ない可能性があります。当社グループでは、地震による損害発生に備えて地震保険に加入しておりますが、それにより全ての損害を補填できるという保証はありません。

⑤競争による影響

半導体事業は熾烈な競争状態にあり、当社グループは、製品の性能、構成、価格、品質等の様々な点で、国内外の多くの同業他社との激しい競争にさらされております。当社グループでは、競争力の維持強化に向けて、先端技術の開発、設計のプラットフォーム化、原価低減の推進等の様々な施策に取り組んでおりますが、競争力を維持することができなかった場合、製品のマーケットシェアが低下し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、熾烈な市場競争により、製品の販売価格が急激に低下し、原価低減では補い切れずに、粗利益率の悪化に見舞われる可能性があります。

⑥製品の受注獲得から出荷終了までのリスク

当社グループが特定顧客から半導体製品の開発を受注し、その顧客固有の仕様に基づいた製品設計を開始した後、発注元の顧客がその製品を搭載する予定であった最終製品の市場への投入を延期または中止する可能性があることに加え、その製品の機能・性能が顧客の要求に満たない場合には、その製品の採用を中止する可能性があります。また、その顧客は、その製品を組み込んだ最終製品の売れ行きが芳しくない場合、その製品の発注数量を減少させ、または納入期日を延期することがあります。

こうした特定顧客向け製品に係る顧客からの製品計画の変更、発注の減少や延期等は、当社グループの売上や収益性を低下させる可能性があります。

⑦製品の生産に関するリスク

(i) 生産工程のリスク

半導体製品は、非常に複雑な生産工程を経て生産されております。当社グループは、材料当たりの出来高である歩留りを改善するため、生産工程の適切な管理および改良に継続して取り組んでおりますが、この生産工程に何らかの問題が発生した場合は、歩留りの悪化による製品出荷の遅延や出荷数量の減少、最悪の場合は出荷停止の結果を招く可能性があります。

(ii) 原材料、部品、生産設備等の調達

半導体製品の生産にあたっては、その生産に必要な原材料、部品、生産設備等をタイムリーに調達する必要があります。当社グループは、こうした原材料、部品、生産設備等について、供給に関連する問題の発生を回避するため、複数の供給者との緊密な関係構築に努めておりますが、原材料等の中には特定の供給者からしか入手できないものも含まれているため、需給が逼迫した場合や、供給者において自然災害や事故、経営状況の悪化、事業撤退等の事象が発生した場合、これらをタイムリーに調達できず、また調達できる場合でも調達価格が大幅に上昇する可能性があります。

(iii) 製品の欠陥、異常または故障に関するリスク

当社グループでは、様々な施策を通じて、ソフトウェアを含む製品の品質向上に取り組んでおりますが、これらの製品に用いられる技術の高度化、顧客における製品の使用方法の多様化等により、出荷時に発見できない欠陥、異常または故障が製品に存在する場合があります。顧客の最終製品に組み込まれた後に当該欠陥、異常または故障が発見される可能性があります。この場合、製品の返品や交換、損失の補償、製品の採用打ち切りなどの結果につながり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした事態に備えて、当社グループでは、生産物賠償責任保険、生産物回収費用保険等の保険に加入しておりますが、それにより損失を全額補填できるという保証はありません。

(iv) 外部への生産委託に関するリスク

当社グループは、半導体製品の生産の一部を外部のファウンダリ等に委託しております。これら外注先の選定にあたっては、技術力や供給能力等につき、あらかじめ厳しく審査を行い、信頼できる会社を選定しておりますが、外注先の責による納入の遅延や製品の欠陥をはじめとした、生産面でのリスクが生じる可能性を否定できず、特に外注先の生産能力不足により、製品需要の高い時期に当社グループが十分な製品供給を行えない可能性があります。

⑧製品の販売に関するリスク

(i) 主要販売先への依存

当社グループは、製品の最終顧客向け売上高の多くを特定の主要顧客に依存しております。当連結会計年度において、当社グループの最終顧客上位10社に対する売上高は、連結売上高の50%以上を占めており、これらの主要顧客が当社グループ製品の採用を中止し、または著しくその発注数量を減らした場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(ii) 販売特約店等への依存

当社グループは、日本国内およびアジア地域では、製品の大部分を独立系の販売特約店を通じて販売しており、その多くを特定の主要な販売特約店に依存しております。当社グループがこれらの販売特約店に対して、競争力ある販売報奨金やマージンを提供できない場合または販売特約店にとって適切な売上数量を確保できない場合、販売特約店はその取扱製品を当社グループ製品から競合他社の製品に切り替え、その結果、当社グループの売上が減少する可能性があります。

⑨人材の確保

半導体業界においては、優秀な経営者や技術・研究・開発に携わる人材を求める競争が熾烈であります。そのため、当社グループが優秀な人材、特にLSIの設計および半導体製造プロセス技術の分野における科学的、技術的または工学的な経歴を有する人材を確保し続けることができない可能性があります。

⑩年金の積立不足

平成21年3月31日現在、米国会計基準に従って計算した当社グループの予測給付債務残高の合計は、1,393億円であります。また、平成21年3月31日現在の年金資産の公正価値は582億円であり、当社グループの同日における年金制度に係る積立不足額は812億円であります。年金資産の運用については、株式・債券など、市場リスクを伴うものが含まれることから、資産の市場価値が下落すれば、積立不足の金額が拡大する可能性があります。

当社グループは、現行の市場金利の分析に基づき、平成21年3月31日現在において、給付債務の算定に用いられる割引率には2.8%を適用しております。その割引率を引き下げる決定を行った場合、退職給付債務は増加することになります。また、当連結会計年度の退職および年金費用（純額）の算出に用いる長期期待収益率については、2.5%を適用しております。もし、当社グループの長期期待収益率を引き下げる決定を行った場合、退職および年金費用（純額）は増加することになります。

⑪長期性資産の減損のリスク

当社グループは、有形固定資産など多くの長期性資産を保有していますが、長期性資産の連結貸借対照表計上額について、当該資産から得られる将来のキャッシュ・フローによって、資産の残存価額を回収することができるかどうかを定期的に検討しています。当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さない場合は、当社および当社グループは長期性資産につき減損を認識しなければならない可能性があります。

⑫情報管理に関するリスク

当社グループは、事業活動の遂行に関連して、多数の秘密情報を有しております。これらの情報については、秘密情報の管理方法につき定める規程に基づき管理しておりますが、予期せぬ事態により情報が流出するおそれがあり、そのような事態が生じた場合、顧客の信用や社会的信用の低下を招き、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑬環境問題に関するリスク

当社グループは、「NECエレクトロニクス環境方針」のもと、地球温暖化、大気汚染、産業廃棄物、有害物質の規制強化、土壌汚染等、多様化・複合化する環境問題に対して、環境負荷の低減につとめておりますが、今後、当社グループの事業活動に関連して、過失の有無にかかわらず環境問題に対して法的、もしくは社会的責任を負う可能性があります。そのような事態が生じた場合、その対応のために多額の費用負担が発生する可能性や、当社グループの社会的信用の低下を招く可能性があります。

⑭法的事項等

当社グループは、グローバルな事業展開を行っております。このような状況下では、訴えや損害賠償請求を受けたり、その他の争訟に巻き込まれる可能性があります。様々な未解決の案件が常に存在しますが、次の事項を除き、平成21年3月31日現在の当社グループの財政状態および経営成績に重大な影響を与えるものはないと考えております。

当社の米国子会社であるNECエレクトロニクス・アメリカ社は、米国DRAM業界における独占禁止法(反トラスト法)違反行為による損害賠償を求める直接購入者(過去において当社グループから直接DRAMを購入した顧客)からの複数の民事訴訟(集団訴訟)の被告になっておりましたが、これらの集団訴訟は和解により終了しました。現在は、集団訴訟から離脱した一部の顧客と係争中または和解交渉中です。

また、NECエレクトロニクス・アメリカ社は、独占禁止法違反行為による損害賠償を求める、間接購入者(DRAMが含まれた製品の購入者)からの複数の集団訴訟および米国の複数の州の司法長官による訴訟の被告にもなっております。

当社グループは、欧州においてもDRAM業界における競争法違反行為の可能性について欧州委員会が行う調査に協力し、情報提供を行っております。欧州委員会の調査の結果、当社グループに違法な行為があったと判断された場合、欧州委員会は課徴金を賦課する可能性があります。

さらに、当社グループは、これらに加え、TFT液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省、欧州委員会、韓国公正取引委員会およびカナダ競争当局の調査の対象となっており、NECエレクトロニクス・アメリカ社は、カナダにおいてTFT液晶ディスプレイ業界における独占禁止法違反行為による損害賠償を求める複数の民事訴訟の被告となっております。

また、SRAM業界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法省、欧州委員会および韓国公正取引委員会の調査は終了しましたが、NECエレクトロニクス・アメリカ社および当社は、米国およびカナダにおいてSRAM業界における独占禁止法違反による損害賠償を求める複数の民事訴訟の被告となっております。

これらの独占禁止法違反を理由とする民事訴訟、和解交渉および当局による種々の調査については、現時点では結論は出ておりませんが、DRAMに係る米国での民事訴訟および和解交渉ならびに欧州委員会による調査に関連して今後当社グループに発生する可能性のある費用の現時点の最善の見積額約11,900百万円を未払金および未払費用に計上しております。ただし、今後の進展にともない、この見積額は増減する可能性があります。その他の民事訴訟および当局による種々の調査については、訴訟に関連する賠償責任の有無および調査に関連する被疑行為の有無が判断できないこと、またこれらに係る費用や損失の額を合理的に見積もることができないため、現時点では計上しておりません。

<親会社等との関係について>

①日本電気(株)(以下、NECいう)との関係の概要

当社は、NEC(平成21年3月31日現在、退職給付信託に拠出している分を含め、当社株式の約70%を実質的に保有する株主)の子会社であります。NECが保有する議決権は、当社の総株主の議決権の3分の2以上であるため、NECは当社の株主総会の決議事項の全てを決定する地位を有しております。

②当社グループの事業と知的財産権

当社は、会社分割の際に半導体事業に係る特許をNECから承継しておりますが、NECが締結した特許クロスライセンス契約の一部を承継しておりません。当社は、NECの子会社として、これらの契約の間接的な受益者としての地位にあり、NECによる当社議決権の直接または間接の保有割合が50%以下となった場合、受益者としての地位を喪失する可能性があります。当社では、こうした事態に備え、特許クロスライセンス契約の更改時に、当社を直接の当事者とする契約形態に切り替える交渉を進めておりますが、契約の切り替えが未了の相手先に関しては、このリスクが継続することになります。

③「NEC」標章の使用許諾

当社は、NECとの「NEC」標章等使用許諾契約に基づき、「NEC」標章を使用しております。当社が提供する製品・役務の品質が不十分であった場合、当社による「NEC」標章の使用がNECの事業運営に悪影響を及ぼすものと認められた場合またはNECによる当社議決権の保有割合が50%以下となった場合、NECはその契約を解除する可能性があり、この場合、当社は多大な経営資源を投じて新しいブランドを開発・育成することになります。

2. 企業集団の状況

当社企業グループの連結子会社（21社）を事業分野別に記載すると次のとおりとなります。

生産会社	販売会社
NECセミコンダクターズ山形(株) (注①)	NECエレクトロニクス・ヨーロッパ社
NECセミコンダクターズ関西(株) (注②)	NECエレクトロニクスUK社 (注⑧)
NECセミコンダクターズ九州・山口(株) (注③)	NECエレクトロニクス台湾社
NECファブサーブ(株) (注④)	NECエレクトロニクス・シンガポール社
NECエレクトロニクス・アメリカ社 (注⑤)	NECエレクトロニクス中国社 (注⑨)
NECセミコンダクターズ・アイルランド社 (注⑥)	NECエレクトロニクス香港社
NECセミコンダクターズ・シンガポール社	NECエレクトロニクス上海社
NECセミコンダクターズ・マレーシア社	NECエレクトロニクス韓国社
NECセミコンダクターズ・インドネシア社 (注⑦)	
首鋼NECエレクトロニクス社	

設計会社	その他
NECマイクロシステム(株)	日本電子ライト(株) (株)近畿分析センター

(注①) 山形日本電気(株)は、平成20年4月1日付でNECセミコンダクターズ山形(株)に商号変更しました。

(注②) 関西日本電気(株)は、平成20年4月1日付で福井日本電気(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ関西(株)に商号変更しました。

(注③) 九州日本電気(株)は、平成20年4月1日付で山口日本電気(株)およびNECセミコンパッケージ・ソリューションズ(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ九州・山口(株)に商号変更しました。

(注④) NECファブサーブ(株)は、平成20年12月をもってその事業活動を終了しました。

(注⑤) NECエレクトロニクス・アメリカ社は、生産および販売を担当しております。

(注⑥) NECセミコンダクターズ・アイルランド社は、平成18年9月をもって生産および出荷活動を終了しました。

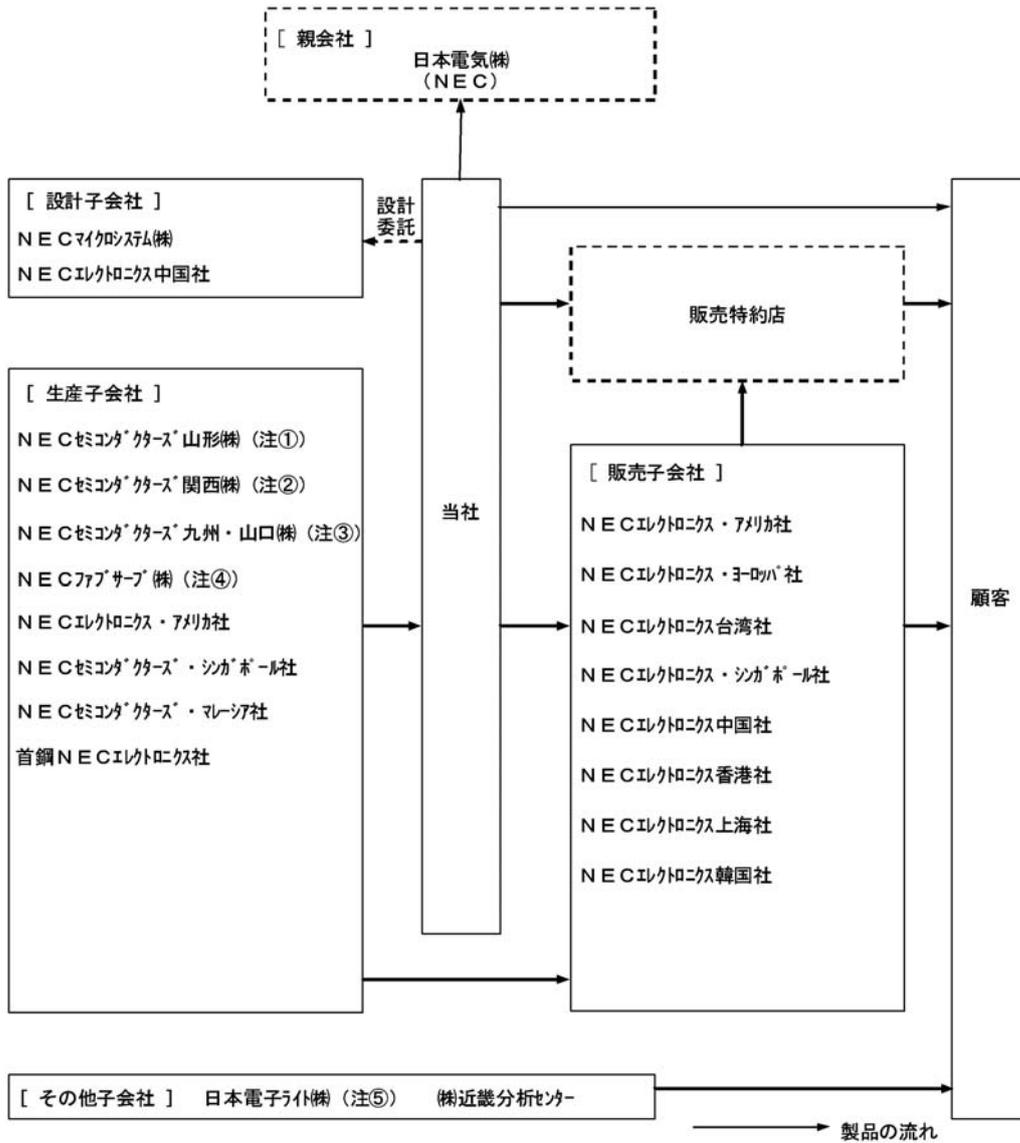
(注⑦) NECセミコンダクターズ・インドネシア社は、平成19年10月をもって生産および出荷活動を終了しました。

(注⑧) NECエレクトロニクスUK社は、休眠会社です。

(注⑨) NECエレクトロニクス中国社は、販売および設計を担当しております。

【事業系統図】

当社グループにおける主要な関係会社の事業の系統は、概ね図のとおりです。



- (注①) 山形日本電気(株)は、平成20年4月1日付でNECセミコンダクターズ山形(株)に商号変更しました。
- (注②) 関西日本電気(株)は、平成20年4月1日付で福井日本電気(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ関西(株)に商号変更しました。
- (注③) 九州日本電気(株)は、平成20年4月1日付で山口日本電気(株)およびNECセミコンパッケージ・ソリューションズ(株)を吸収合併し、NECセミコンダクターズ九州・山口(株)に商号変更しました。
- (注④) NECファブサブ(株)は、平成20年12月をもってその事業活動を終了しました。
- (注⑤) 日本電子ライト(株)の販売は、関西日本電気(株)を経由して販売している製品も含まれています。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、次の方針に基づき、半導体のグローバルリーディングカンパニーを目指し、企業価値・株主価値の増大に努めてまいります。

- ・ S o C (システム・オン・チップ)、マイクロコンピュータ、個別半導体という3つの製品群を主力事業とし、自動車・産業機器、民生機器向けに注力します。
- ・ 開発と製造の緊密な連携により、新たな力・価値を創り出します。
- ・ 開発・製造・サポートまで一貫責任を持つことにより、「お客様の信頼」に応えます。
- ・ 新たな価値を創出する製品群や分野を開拓・展開し、「社会の信頼」に応えます。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、総資産利益率・株主資本利益率の向上のためには、売上高に対する利益率を改善することが最重要と考えており、できるだけ早期に連結の売上高営業利益率を二桁のレベルに向上させるよう取り組んでまいります。しかしながら、当連結会計年度の業績は大幅な営業赤字となったことから、まずは一刻も早い黒字化を果たすべく、固定費の削減をはじめとする体質改善施策を断行いたします。さらに、引き続き当社グループ丸となって様々な施策を実行することにより、昨今のような厳しい事業環境にも迅速に対応し、着実に利益を確保できる強靱な企業体質の構築を目指してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

上記の基本方針の実現のため、中期的な経営戦略として、次の施策を実行してまいります。

① 開発と製造を一貫化した製品群ごとの事業運営

当社グループの主力製品はS o C、マイクロコンピュータ、個別半導体の3製品群から構成されています。従来、当社は機能別組織体制を採用しておりましたが、これら3製品群ごとにビジネスユニット化し、さらに、平成20年4月には生産子会社についてもビジネスユニット単位に再編するなど、損益管理の強化に努めております。この製品別組織体制により、それぞれ開発から製造・サポートまでの一貫化によるコスト・品質・デリバリの競争力を一層強化することが可能になり、開発と製造の緊密な連携による最先端L S Iの超短期量産立上げや歩留り向上など成果が着実に出てきております。今後もこの取り組みを強化することで当社グループの競争力強化を図ってまいります。

② 注力分野へのフォーカスによる製品競争力の強化

当社グループは、自動車・産業機器分野と民生機器分野を注力分野と位置づけております。自動車・産業機器分野向け半導体では高信頼性と長期安定供給が不可欠であり、また民生機器分野向け半導体では画像処理技術、低消費電力技術が求められることなど、当社グループがこれまで培った強みが十分に発揮できる事業特性環境にあると考えております。

当社グループは、既にこれらの分野において世界的に業界をリードするお客様との良好なビジネス関係を有しておりますが、今後も、開発リソースを自動車・産業、民生機器分野にフォーカスすることにより、さらなる競争力の強化を図ってまいります。

③ お客様と社会の信頼に応える企業

当社グループにとって、開発サポート力、開発納期の遵守、量産品の品質維持・向上、不具合に対する迅速な対応、安定的な供給等、これらについての継続的な取り組みは、お客様から長期的な評価をいただけるものであり、競合他社との持続的な差異化が図れる価値でもあります。さらに、お客様のニーズに応じて持続的な差異化が図れる競争力を高めることが「お客様の信頼」をえることとなります。また、地球環境の保全や、安全・安心な生活や社会となることが今後ますます求められる中、当社グループの強みである低消費電力半導体や高品質半導体は、これらの進展に必ず貢献できる事業だと考えており、これらを追求することにより「社会の信頼」にも

応えることができると考えています。

当社グループは、半導体のグローバルリーディングカンパニーを目指し、「お客様の信頼」と「社会の信頼」に応える企業として、今後も事業運営をおこなってまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループでは、半導体の市場環境が当連結会計年度の後半から急激に悪化し、平成13年のITバブル崩壊時を超える厳しい状況にあることから、自らの体質を抜本的に強化し、早期に収益性の回復をはかるべく、次のとおり、製造ラインの再編をはじめとした構造改革のさらなる加速や強い競争力と成長力の期待できる製品の開発などの課題に取り組んでまいります。

① 事業環境の急激な悪化を踏まえたコスト構造再構築のさらなる加速

当社グループでは、平成19年2月に発表した経営方針に基づき、コスト構造の継続的な改善に努めた結果、前期(平成20年3月期)には連結営業損益の黒字化を達成いたしました。しかしながら、昨年夏以降、当社グループを取り巻く事業環境は急激に悪化し、さらに為替相場も円高が急速に進行した結果、当連結会計年度において、当社グループの主力事業である半導体売上高は前期と比べ大幅な減収となり、連結営業赤字を計上する結果となりました。このような事業の状況を踏まえ、昨夏以前から大きく減少した売上水準に対応したコスト構造の再構築を経営全般にわたって加速させることが当社グループの緊要の課題であることを認識し、その実行に取り組んでまいります。

当社グループでは、製造ラインの再編に関し、ウエハ処理工程(前工程)の拠点については、従来から製造ラインの統廃合や個々の製造ラインの規模拡大による製造効率の改善を進めておりましたが、これを一層加速させ、国内外の拠点(NECセミコンダクターズ九州・山口(嵯川)工場、NECエレクトロニクス・アメリカ社カリフォルニア州ローズビル工場)の6インチウエハ製造ラインを、平成22年3月を目処にそれぞれ閉鎖するとともに、組立・検査工程(後工程)の拠点についても、従来と同様、海外への移管を積極的に進めてまいります。また、設備投資の抑制や人員配置の最適化などにより、人件費、減価償却費、用力費等の製造に関連する固定的な経費の削減にも取り組んでまいります。研究開発については、開発品種の採算性の精査や、インドをはじめとした海外の開発リソースの有効活用により、売上高に対する研究開発費の比率を横ばい以下に抑制してまいります。それらに加え、次期(平成22年3月期)については、役員や従業員の報酬・給与削減を含む人件費等の諸経費の削減施策を緊急施策として実施いたします。当社グループとしては、これらの体質改善に向けた施策を断行することにより、次期において、連結営業損益の黒字化を目指します。

② 半導体市況の回復を見据えた競争力の強い製品作りと海外売上比率の拡大

当社グループでは、上述のとおり、昨今の急激な事業環境の悪化等に対応するため、大幅な固定的な費用の削減に取り組んでまいりますが、こうした固定的な経費の中には、将来の成長に向けた設備投資や製品開発のための研究開発費も含まれており、こうした将来への先行投資と足もとのコスト削減の間のバランスをいかに図るかが重要な経営課題であると認識しております。

当社グループは、当期において半導体市場が大きく悪化する中、当社グループの強みである画像処理技術や低消費電力技術が評価され、32ビットマイクロコントローラをはじめとするマイクロコントローラ分野や、DRAM混載LSIをはじめとするASIC(特定用途向けIC)分野において、世界半導体マーケット・シェアを高めております。当社グループとしては、マイクロコントローラやDRAM混載LSIなど、将来世界的に成長が期待できる「省エネ/エコロジー」製品市場に対応できる製品群を「ecoプロダクト」と位置付け、当社グループの開発資源を集中するとともに、マイクロコントローラを中心とする強い製品の競争力を活用し、インターフェースや電源など周辺のアナログ製品やディスクリット製品への展開も図っております。こうした注力製品への開発資源投入の「選択と集中」をさらに進めて、強い競争力と成長力が期待できる製品の開発・提供に努めてまいります。

また、世界の半導体市場においては、日本は世界トップクラスの半導体消費地となっておりますが、近年、日本以外のアジア市場、特に中国の市場拡大が急速に進んでおり、中国・アジア市場でいかに売上シェアの拡大を図っていくかが今後の半導体企業の成長を左右する鍵となっております。当社グループでは、中国・アジア市場向けの販売拠点の整備と、現地の販売員および営業技術員の増員をさらに進めるとともに、現地の需要に対応した製品の開発を強化することにより、急成長を続ける中国・アジア市場での売上シェアを高め、当社グループの海外売上比率50%以上の早期達成に努めてまいります。

(5) 企業の社会的責任

当社グループは、平成16年6月に、経営指針となる「NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章」を制定するとともに、CSR推進委員会を設置するなど、全社的なCSR(Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責任)推進体制を整えました。平成17年4月には、個人情報保護法の全面施行を受け、規程の見直しや社内への周知徹底など、個人情報保護の推進体制を整備しました。また、平成20年3月には、日本の半導体専業企業としては初めて、国際連合が提唱する「グローバル・コンパクト」へ参加いたしました。さらに、当社グループでは、持続可能な社会の実現に向けて組織が発行する報告書の世界的な基準「GRIサステナビリティガイドライン」に沿って、環境・CSRレポート、アニュアル・レポートの各報告書による情報開示を行っております。

地域に密着した社会貢献活動としては、従来から行っている水源林保護活動や地域の清掃活動に加えて、平成18年10月から地元の小学生たちに電子・電気に関心を深めてもらうことを目的として、半導体を活用した電子工作教室を開催するなど、地域社会との積極的な交流を図っております。

当社グループは、次の憲章に基づき、良き企業市民として社会的責任を果たすことが継続的な企業価値・株主価値の増大につながると考えております。

NECエレクトロニクスグループ企業行動憲章

私たちNECエレクトロニクスグループは、健全な事業活動をとおして、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、従業員をはじめとするすべての関係者から信頼される存在となることを目指しています。

そのため、良き企業市民として法令を守って誠実に行動し、以下の指針に基づいて社会的責任を果たしていくとともに、高い技術力を基盤とした魅力ある半導体ソリューションの提供に取り組んでまいります。

- ・お客様志向
最適かつ高品質のソリューション提供をとおして、お客様の満足向上を追求し、お客様からの揺るぎない信頼を獲得します。
- ・誠実で透明な企業活動
公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進するとともに、その活動内容の積極的な公開に努めます。
- ・地域社会、国際社会への貢献
グローバルカンパニーとして、国や地域の歴史、文化、慣習、人権を尊重し、地域社会、国際社会に貢献します。
- ・地球環境の保全
製品の開発、生産、販売、使用、廃棄にいたるまでのライフサイクルにおいて、環境負荷を低減し、持続可能な社会の発展に寄与します。
- ・誇りある企業文化
従業員一人ひとりの個性を尊重し、その資質、能力が最大限に発揮される、活力ある組織を実現します。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)	当連結会計年度末 (平成21年3月31日)	増(減)
(資産の部)			
流動資産	344,115	222,177	△121,938
現金および現金同等物	165,472	101,279	△64,193
受取手形および売掛金	96,352	52,488	△43,864
たな卸資産	75,839	63,220	△12,619
その他の流動資産	6,452	5,190	△1,262
固定資産	272,189	260,368	△11,821
投資等	4,565	3,474	△1,091
有形固定資産	259,151	242,079	△17,072
その他の資産	8,473	14,815	6,342
資産合計	616,304	482,545	△133,759
(負債・資本の部)			
流動負債	179,715	141,907	△37,808
短期借入金	2,394	1,905	△489
支払手形および買掛金	108,136	78,763	△29,373
その他の流動負債	69,185	61,239	△7,946
固定負債	204,275	208,387	4,112
社債および長期借入金	114,207	114,966	759
未払退職および年金費用	74,460	81,167	6,707
その他の固定負債	15,608	12,254	△3,354
少数株主持分	5,176	4,121	△1,055
資本	227,138	128,130	△99,008
資本金	85,955	85,955	—
資本剰余金	281,073	281,081	8
利益剰余金	△114,896	△197,521	△82,625
その他の包括損益累計額	△24,984	△41,374	△16,390
自己株式	△10	△11	△1
負債、少数株主持分および資本合計	616,304	482,545	△133,759
有利子負債残高	116,601	116,871	270
株主資本比率	36.9%	26.6%	△10.3%
D/E レシオ	0.51倍	0.91倍	0.40倍

【その他の包括損益累計額内訳】

・外貨換算調整額	1,913	△6,563	△8,476
・年金負債調整額	△27,737	△34,948	△7,211
・有価証券未実現損益	840	137	△703

(注) 連結貸借対照表の一部の金額について、平成21年3月末の表示に合わせて組替え再表示しております。

(2) 連結損益計算書

(単位 百万円)

科 目	前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		前 期 比 増 (減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
		%		%	
売 上 高	687,745	100.0	546,470	100.0	△141,275
売 上 原 価	485,683	70.6	425,918	77.9	△59,765
研 究 開 発 費	112,300	16.3	110,380	20.2	△1,920
販売費および一般管理費	84,668	12.4	78,527	14.4	△6,141
営 業 損 益	5,094	0.7	△68,355	△12.5	△73,449
営 業 外 収 益	6,053	0.9	3,761	0.7	△2,292
受取利息および配当金	2,152		1,570		△582
雑 収 益	3,901		2,191		△1,710
営 業 外 費 用	14,399	2.1	24,741	4.5	10,342
支 払 利 息	741		319		△422
雑 損 失	13,658		24,422		10,764
税 引 前 損 益	△3,252	△0.5	△89,335	△16.3	△86,083
法 人 税 等	12,285	1.8	△6,115	△1.0	△18,400
少数株主損益(控除)	251	0.0	△288	△0.1	△539
持分法による投資損益	△207	△0.0	307	0.1	514
当 期 純 損 益	△15,995	△2.3	△82,625	△15.1	△66,630

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(3) 連結資本勘定計算書

前連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（単位 百万円）

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
期首残高	85,955	281,039	△98,901	△3,017	△8	265,068
ストック・オプションに係る報酬費用 包括損益		34				34
当期純損益			△15,995			△15,995
その他の包括損益（税効果調整後）						
外貨換算調整額				△8,589		△8,589
年金負債調整額				△11,800		△11,800
有価証券未実現損益				△1,578		△1,578
包括損益 合計						△37,962
自己株式の取得（取得原価）					△2	△2
期末残高	85,955	281,073	△114,896	△24,984	△10	227,138

当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位 百万円）

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
期首残高	85,955	281,073	△114,896	△24,984	△10	227,138
ストック・オプションに係る報酬費用 包括損益		8				8
当期純損益			△82,625			△82,625
その他の包括損益（税効果調整後）						
外貨換算調整額				△8,476		△8,476
年金負債調整額				△7,211		△7,211
有価証券未実現損益				△703		△703
包括損益 合計						△99,015
自己株式の取得（取得原価）					△1	△1
期末残高	85,955	281,081	△197,521	△41,374	△11	128,130

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

項 目	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	前 期 比 増 (減)
<u>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>			
当期純損益	△15,995	△82,625	△66,630
営業活動により増加したキャッシュ (純額) への調整			
減価償却費等	75,067	67,346	△7,721
受取手形および売掛金の (増加) 減少額	△3,710	39,117	42,827
たな卸資産の (増加) 減少額	856	10,911	10,055
支払手形および買掛金の増加 (減少) 額	△17,309	△31,166	△13,857
そ の 他	4,353	△10,516	△14,869
計	43,262	△6,933	△50,195
<u>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>			
有形固定資産売却額	20,653	6,271	△14,382
有形固定資産購入額	△62,188	△53,035	9,153
そ の 他	3,766	△2,492	△6,258
計	△37,769	△49,256	△11,487
フリー・キャッシュ・フロー (I + II)	5,493	△56,189	△61,682
<u>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>			
社債および借入金の増加 (減少) 額	△20,456	△1,587	18,869
そ の 他	△2,529	△2,708	△179
計	△22,985	△4,295	18,690
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△2,408	△3,709	△1,301
現金および現金同等物純増加 (減少) 額	△19,900	△64,193	△44,293
現金および現金同等物期首残高	185,372	165,472	△19,900
現金および現金同等物期末残高	165,472	101,279	△64,193

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結範囲および持分法の適用に関する事項

連結子会社数 21社
持分法適用会社数 1社

2. 重要な会計方針

(1) 連結財務諸表の作成基準

当社の連結財務諸表は、米国会計基準に準拠して作成しております。

(2) たな卸資産の評価方法および評価基準

主として先入先出法による低価法を採用しております。

(3) 有価証券の評価方法および評価基準

米国財務会計基準審議会基準書（以下、「基準書」）第115号「負債証券投資および持分証券投資の会計」を適用しております。

売却可能有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(4) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却方法は、主として定率法を採用しております。

無形固定資産の減価償却方法は、主として定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、過去の貸倒損失の実績ならびに回収可能性に疑義がある債権の個別評価に基づいて計上しております。

② 退職給付引当金

基準書第87号「事業主の年金会計」および基準書第158号「確定給付型年金および他の退職給付制度に関する事業主の会計処理」を適用しております。

(6) 会計方針の変更

平成20年4月1日以降、基準書第157号「公正価値の測定」を適用しております。基準書第157号は、公正価値を定義し、公正価値を測定するための枠組みを確立するとともに、公正価値の測定に関する開示を拡大しております。基準書第157号の適用が当社グループの財政状態および経営成績に与える重要な影響はありません。基準書第157号の適用による詳細については決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。

平成21年1月1日以降、基準書第161号「デリバティブおよびヘッジ活動に関する開示ー基準書第133号の改訂」を適用しております。基準書第161号は、デリバティブおよびヘッジ活動についての開示内容を改善しております。基準書第161号の適用が当社グループの財政状態および経営成績に与える重要な影響はありません。基準書第161号の適用による詳細については決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。

セグメント情報

①製品分野別売上高

(単位 百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)			前年同期比 増(減)
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	
通信機器分野	70,350	10.2	60,199	11.0	△14.4	△10,151
コンピュータおよび周辺機器分野	119,352	17.4	87,237	16.0	△26.9	△32,115
民生用電子機器分野	134,546	19.6	119,330	21.8	△11.3	△15,216
自動車および産業機器分野	113,320	16.5	91,492	16.8	△19.3	△21,828
多目的・多用途IC	89,643	13.0	70,478	12.9	△21.4	△19,165
ディスクリート・光・マイクロ波	126,064	18.3	92,999	17.0	△26.2	△33,065
半 導 体 計	653,275	95.0	521,735	95.5	△20.1	△131,540
そ の 他	34,470	5.0	24,735	4.5	△28.2	△9,735
合 計	687,745	100.0	546,470	100.0	△20.5	△141,275

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

(単位 百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)			前年同期比 増(減)
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	
SOCプラットフォーム	251,295	36.5	222,536	40.7	△11.4	△28,759
MCUプラットフォーム	180,113	26.2	141,837	26.0	△21.3	△38,276
個別半導体	221,867	32.3	157,362	28.8	△29.1	△64,505
半 導 体 計	653,275	95.0	521,735	95.5	△20.1	△131,540
そ の 他	34,470	5.0	24,735	4.5	△28.2	△9,735
合 計	687,745	100.0	546,470	100.0	△20.5	△141,275

(注)

SOC(システム・オン・チップ)プラットフォーム: ASIC(特定用途向け集積回路)、ASSP(特定用途向け標準品)、メモリ
MCU(マイクロコンピュータ)プラットフォーム: マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ
個別半導体: 表示ドライバ、アナログIC、ディスクリート半導体、化合物半導体

②所在地別売上高

(単位 百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)
日 本	370,238	53.8	301,617	55.2	△18.5
米 国	58,256	8.5	38,638	7.1	△33.7
欧 州	95,936	14.0	74,468	13.6	△22.4
ア ジ ア	163,315	23.7	131,747	24.1	△19.3
合 計	687,745	100.0	546,470	100.0	△20.5

③所在地別営業損益

(単位 百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増(減) (百万円)
日 本	△9,386	—	△66,287	—	△56,901
米 国	755	—	△5,326	—	△6,081
欧 州	2,023	—	△238	—	△2,261
ア ジ ア	11,702	—	3,496	—	△8,206
合 計	5,094	—	△68,355	—	△73,449

金融商品

(1) デリバティブ

各デリバティブ取引における帳簿価額および公正価値は次のとおりです。

(単位 百万円)

	平成20年3月末		平成21年3月末	
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
デリバティブ取引 為替予約	1,520	1,520	△1,167	△1,167

(2) 市場性ある有価証券

市場性ある有価証券について、有価証券の種類ごとの取得価額と時価および未実現損益は次のとおりです。

(単位 百万円)

	平成20年3月末	平成21年3月末
売却可能有価証券		
持分証券		
取得価額	1,933	1,927
時価	3,345	2,158
未実現損益	1,412	231

リース取引

当社は、一部の設備については、リース契約による賃借資産を使用しております。

オペレーティング・リースに分類される賃借資産の解約不能期間に係る未経過リース料はそれぞれ次のとおりです。

(単位 百万円)

	平成20年3月末	平成21年3月末
1 年 内	25,499	22,216
1 年 超	40,555	23,488

ストック・オプション

決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略します。

1株当たり当期純損益

基本的小および希薄化後1株当たり当期純損益の計算における分母の調整は次のとおりです。

	平成20年3月期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	平成21年3月期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	増(減)
当期純損益(単位 百万円)	△15,995	△82,625	△66,630
株式数(単位 株)			
加重平均発行済普通株式数	123,498,165	123,497,808	△357
希薄化効果のある証券の影響	—	—	—
希薄化後加重平均発行済普通株式数	123,498,165	123,497,808	△357
1株当たり当期純損益(単位 円)			
基本的	△129.52	△669.04	△539.52
希薄化後	△129.52	△669.04	△539.52

逆希薄化効果があるため、希薄化後1株当たり当期純損益の計算には含めておりませんが、将来潜在的に1株当たり損益を希薄化する可能性のある証券は次のとおりです。

(単位 株)

	平成20年3月期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	平成21年3月期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	増(減)
転換社債	11,156,100	11,156,100	—
ストック・オプション	72,000	72,000	—

設備投資額・研究開発費

(単位 百万円)

	平成20年3月期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	平成21年3月期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	増(減)
設備投資額	56,128	56,573	445
減価償却費等	75,067	67,346	△7,721
研究開発費	112,300	110,380	△1,920

(注) 設備投資額は、有形固定資産(ソフトウェアを除く)取得額を表示しております。

重要な後発事象

当社は、平成21年4月27日開催の取締役会において、㈱ルネサス テクノロジとの間で、当社と同社の経営統合に向けた協議の開始について基本合意することを決議し、同日付で覚書を締結しました。

世界の半導体市場においては、製品の性能、構成、価格、品質等の様々な点で激しい競争が繰り広げられており、半導体企業各社はこうした事業環境に迅速に対応していくことが迫られています。このような状況のもと、当社は、その経営基盤と技術力をより一層強固なものとし、顧客満足のさらなる向上を通じて企業価値の増大を図ることを目指し、平成22年4月を目処に㈱ルネサス テクノロジと経営統合することについて協議を開始すること、経営統合後の会社は株式市場への上場維持を基本とすること等で基本合意しました。

本経営統合の詳細条件については、平成21年7月を目処に正式契約を締結する方向で、今後、関係当事者間で協議してまいります。なお、本経営統合は、別途両社の株主総会の承認と関係当局の許認可等が得られることを条件として実施される予定です。

なお、本経営統合の相手方である㈱ルネサス テクノロジの概要(平成21年3月31日現在)は、次のとおりです。

- ①商号：㈱ルネサス テクノロジ
- ②事業内容：システムLSI、ディスクリット半導体およびメモリ製品の開発
設計、製造、販売およびサービスの提供
- ③本店所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番2号
- ④設立年月日：平成15年4月1日
- ⑤資本金：77,000百万円
- ⑥株主構成：㈱日立製作所（55%）、三菱電機㈱（45%）

<参考> 四半期連結財務諸表(3か月)

(1) 四半期連結損益計算書(3か月)

(第4四半期連結会計期間)

(単位 百万円)

科 目	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)		前年同期比 増(減)
		対売上 高比率		対売上 高比率	
		%		%	
売 上 高	165,994	100.0	85,546	100.0	△80,448
売 上 原 価	120,497	72.6	94,588	110.6	△25,909
研 究 開 発 費	24,594	14.8	26,948	31.5	2,354
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	20,663	12.5	17,328	20.2	△3,335
営 業 損 益	240	0.1	△53,318	△62.3	△53,558
営 業 外 収 益	874	0.5	536	0.6	△338
受 取 利 息 お よ び 配 当 金	531		218		△313
雑 収 益	343		318		△25
営 業 外 費 用	7,841	4.7	16,435	19.2	8,594
支 払 利 息	117		48		△69
雑 損 失	7,724		16,387		8,663
税 引 前 損 益	△6,727	△4.1	△69,217	△80.9	△62,490
法 人 税 等	5,426	3.2	△7,785	△9.1	△13,211
少 数 株 主 損 益 (控 除)	5	0.0	△451	△0.5	△456
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	131	0.1	162	0.2	31
四 半 期 純 損 益	△12,027	△7.2	△60,819	△71.1	△48,792

(注) 当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

(2) 四半期連結資本勘定計算書(3か月)

前第4四半期連結会計期間(平成20年1月1日～平成20年3月31日)

(単位 百万円)

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
四半期首残高	85,955	281,065	△102,869	△5,296	△10	258,845
ストック・オプションに係る報酬費用		8				8
包括損益						
四半期純損益			△12,027			△12,027
その他の包括損益(税効果調整後)						
外貨換算調整額				△7,029		△7,029
年金負債調整額				△11,867		△11,867
有価証券未実現損益				△792		△792
包括損益 合計						△31,715
四半期末残高	85,955	281,073	△114,896	△24,984	△10	227,138

当第4四半期連結会計期間(平成21年1月1日～平成21年3月31日)

(単位 百万円)

	資本金	資本 剰余金	利益剰余金	その他の 包括損益 累計額	自己株式	合計
四半期首残高	85,955	281,081	△136,702	△33,405	△11	196,918
包括損益						
四半期純損益			△60,819			△60,819
その他の包括損益(税効果調整後)						
外貨換算調整額				481		481
年金負債調整額				△8,080		△8,080
有価証券未実現損益				△370		△370
包括損益 合計						△68,788
四半期末残高	85,955	281,081	△197,521	△41,374	△11	128,130

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(3か月)

(第4四半期連結会計期間)

(単位 百万円)

項 目	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)	当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)	前年同期比 増(減)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
四半期純損益	△12,027	△60,819	△48,792
営業活動により増加したキャッシュ(純額)への調整			
減価償却費等	19,305	16,992	△2,313
受取手形および売掛金の(増加)減少額	△10,141	16,858	26,999
たな卸資産の(増加)減少額	3,904	20,953	17,049
支払手形および買掛金の増加(減少)額	△6,683	△32,792	△26,109
その他	6,131	2,509	△3,622
計	489	△36,299	△36,788
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産売却額	13,959	1,581	△12,378
有形固定資産購入額	△17,698	△19,774	△2,076
その他	△531	△494	37
計	△4,270	△18,687	△14,417
フリー・キャッシュ・フロー(I+II)	△3,781	△54,986	△51,205
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
社債および借入金の増加(減少)額	△16,135	△73	16,062
その他	△577	△559	18
計	△16,712	△632	16,080
為替相場変動の現金および現金同等物への影響額	△2,966	401	3,367
現金および現金同等物純増加(減少)額	△23,459	△55,217	△31,758
現金および現金同等物期首残高	188,931	156,496	△32,435
現金および現金同等物期末残高	165,472	101,279	△64,193

(4) セグメント情報(3か月)

(第4四半期連結会計期間)

①製品分野別売上高

(単位 百万円)

	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)			前年同期比 増(減)
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	
通信機器分野	16,986	10.2	12,101	14.1	△28.8	△4,885
コンピュータおよび周辺機器分野	27,122	16.4	9,673	11.3	△64.3	△17,449
民生用電子機器分野	31,719	19.1	23,431	27.4	△26.1	△8,288
自動車および産業機器分野	29,222	17.6	12,672	14.8	△56.6	△16,550
多目的・多用途IC	20,309	12.2	10,485	12.3	△48.4	△9,824
ディスクリート・光・マイクロ波	30,085	18.1	12,348	14.4	△59.0	△17,737
半 導 体 計	155,443	93.6	80,710	94.3	△48.1	△74,733
そ の 他	10,551	6.4	4,836	5.7	△54.2	△5,715
合 計	165,994	100.0	85,546	100.0	△48.5	△80,448

<参考> プラットフォーム別売上高

当社は、製品分野別売上高に加えて、事業特性の類似するプラットフォーム別の売上高も開示しております。

(単位 百万円)

	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)			前年同期比 増(減)
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)	
SOCプラットフォーム	59,123	35.6	39,041	45.6	△34.0	△20,082
MCUプラットフォーム	44,778	27.0	20,846	24.4	△53.4	△23,932
個別半導体	51,542	31.0	20,823	24.3	△59.6	△30,719
半 導 体 計	155,443	93.6	80,710	94.3	△48.1	△74,733
そ の 他	10,551	6.4	4,836	5.7	△54.2	△5,715
合 計	165,994	100.0	85,546	100.0	△48.5	△80,448

(注)

SOC(システム・オン・チップ)プラットフォーム: ASIC(特定用途向け集積回路)、ASSP(特定用途向け標準品)、メモリ
MCU(マイクロコンピュータ)プラットフォーム: マイクロコントローラ、カーオーディオコントローラ
個別半導体: 表示ドライバ、アナログIC、ディスクリート半導体、化合物半導体

②所在地別売上高

(単位 百万円)

	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増減率 (%)
日本	91,740	55.3	47,639	55.7	△48.1
米国	13,509	8.1	6,481	7.6	△52.0
欧州	24,996	15.1	14,162	16.5	△43.3
アジア	35,749	21.5	17,264	20.2	△51.7
合計	165,994	100.0	85,546	100.0	△48.5

③所在地別営業損益

(単位 百万円)

	前第4四半期 連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		当第4四半期 連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)		
		構成比 (%)		構成比 (%)	前年同期比 増(減) (百万円)
日本	△4,401	—	△47,613	—	△43,212
米国	726	—	△2,866	—	△3,592
欧州	1,478	—	△983	—	△2,461
アジア	2,437	—	△1,856	—	△4,293
合計	240	—	△53,318	—	△53,558

5. 個別財務諸表
 (1) 貸借対照表

(単位 百万円)

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	30,488	37,851
受取手形	83	99
売掛金	67,183	34,646
有価証券	121,958	52,581
製品	8,401	7,308
原材料	7,424	—
仕掛品	895	372
貯蔵品	5,156	—
原材料及び貯蔵品	—	12,607
前払費用	142	186
関係会社短期貸付金	127,418	152,915
未収入金	18,918	10,058
その他	1,587	2
貸倒引当金	△2	△1,598
流動資産合計	389,651	307,028
固定資産		
有形固定資産		
建物	19,838	16,603
減価償却累計額	△13,718	△11,973
建物(純額)	6,120	4,630
構築物	113	95
減価償却累計額	△66	△41
構築物(純額)	47	54
機械及び装置	60,536	45,286
減価償却累計額	△47,528	△38,544
機械及び装置(純額)	13,008	6,741
車両運搬具	3	3
減価償却累計額	△3	△3
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	26,046	23,510
減価償却累計額	△21,235	△19,589
工具、器具及び備品(純額)	4,811	3,921
建設仮勘定	568	425
有形固定資産合計	24,554	15,772
無形固定資産		
ソフトウェア	14,553	15,431
ソフトウェア仮勘定	5,199	—
その他	56	46
無形固定資産合計	19,808	15,476

(単位 百万円)

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	507	281
関係会社株式	62,737	40,280
長期前払費用	3,592	9,193
前払年金費用	7,102	3,018
その他	330	556
投資その他の資産合計	74,269	53,327
固定資産合計	118,631	84,576
資産合計	508,282	391,604
負債の部		
流動負債		
支払手形	6	—
買掛金	76,523	49,037
リース債務	—	5
未払金	13,783	8,475
未払費用	18,687	13,819
未払法人税等	284	258
前受金	1,204	369
関係会社預り金	45,275	39,654
製品保証引当金	638	468
その他	223	1,148
流動負債合計	156,623	113,232
固定負債		
新株予約権付社債	110,000	110,000
リース債務	—	11
繰延税金負債	2,646	2,646
その他	1,247	5,872
固定負債合計	113,893	118,529
負債合計	270,516	231,761

(単位 百万円)

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	85,955	85,955
資本剰余金		
資本準備金	21,489	21,489
その他資本剰余金	236,239	236,239
資本剰余金合計	257,728	257,728
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△105,938	△183,879
利益剰余金合計	△105,938	△183,879
自己株式	△10	△11
株主資本合計	237,735	159,793
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△28	△17
評価・換算差額等合計	△28	△17
新株予約権	59	67
純資産合計	237,765	159,843
負債純資産合計	508,282	391,604

(2) 損益計算書

(単位 百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
売上高	588,999	476,516
売上原価	427,017	354,878
売上総利益	161,982	121,638
販売費及び一般管理費	188,783	177,051
営業利益又は営業損失 (△)	△26,801	△55,413
営業外収益		
受取利息	2,711	2,025
有価証券利息	1,231	991
受取配当金	3	6,417
雑収入	343	168
営業外収益合計	4,288	9,601
営業外費用		
支払利息	1,667	883
為替差損	2,576	2,666
退職給付費用	940	940
固定資産廃棄損	1,175	1,112
雑支出	634	689
営業外費用合計	6,992	6,290
経常利益又は経常損失 (△)	△29,505	△52,102
特別利益		
固定資産売却益	2,025	439
関係会社損失引当金戻入益	1,306	—
貸倒引当金戻入額	860	—
子会社清算益	—	686
特別利益合計	4,191	1,125
特別損失		
固定資産売却損	75	98
子会社株式評価損	2,314	22,425
早期退職関連費用	2,038	—
自社利用ソフトウェア臨時償却費	461	—
事業構造改善費用	—	2,589
貸倒引当金繰入額	—	1,598
投資有価証券評価損	—	320
特別損失合計	4,888	27,030
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	△30,201	△78,007
法人税、住民税及び事業税	△1,792	△58
法人税等調整額	8	△7
法人税等合計	△1,784	△65
当期純利益又は当期純損失 (△)	△28,417	△77,941

(3) 株主資本等変動計算書

(単位 百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	85,955	85,955
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	85,955	85,955
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	21,489	21,489
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	21,489	21,489
其他資本剰余金		
前期末残高	236,239	236,239
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	236,239	236,239
利益剰余金		
其他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
前期末残高	△77,521	△105,938
当期変動額		
当期純損失(△)	△28,417	△77,941
当期変動額合計	△28,417	△77,941
当期末残高	△105,938	△183,879
自己株式		
前期末残高	△8	△10
当期変動額		
自己株式の取得	△2	△1
当期変動額合計	△2	△1
当期末残高	△10	△11
株主資本合計		
前期末残高	266,154	237,735
当期変動額		
当期純損失(△)	△28,417	△77,941
自己株式の取得	△2	△1
当期変動額合計	△28,419	△77,942
当期末残高	237,735	159,793

(単位 百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△10	△28
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△19	11
当期変動額合計	△19	11
当期末残高	△28	△17
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	△8	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	8	—
当期変動額合計	8	—
当期末残高	—	—
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△17	△28
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△11	11
当期変動額合計	△11	11
当期末残高	△28	△17
新株予約権		
前期末残高	25	59
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	34	8
当期変動額合計	34	8
当期末残高	59	67
純資産合計		
前期末残高	266,162	237,765
当期変動額		
当期純損失 (△)	△28,417	△77,941
自己株式の取得	△2	△1
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	23	19
当期変動額合計	△28,396	△77,923
当期末残高	237,765	159,843

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

該当事項はありません。

リース取引関係

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)																																																														
1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	<p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,747</td> <td>1,102</td> <td>4,645</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>253</td> <td>138</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,000</td> <td>1,240</td> <td>4,759</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 未経過リース料期末残高相当額 (百万円)</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,580</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,917</td> </tr> </table> <p>3 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 (百万円)</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>347</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>126</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略してあります。</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	建物	5,747	1,102	4,645	機械及び装置	253	138	115	合計	6,000	1,240	4,759	1年内	337	1年超	3,580	合計	3,917	支払リース料	552	減価償却費相当額	347	支払利息相当額	126	<p>1 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,747</td> <td>1,317</td> <td>4,430</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,750</td> <td>1,320</td> <td>4,430</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 未経過リース料期末残高相当額 (百万円)</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,274</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,536</td> </tr> </table> <p>3 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 (百万円)</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>53</td> </tr> </table> <p>4 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>5 利息相当額の算定方法 同左 (減損損失について) 同左</p> <p>未経過リース料 (百万円)</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>15,331</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>12,433</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,765</td> </tr> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	建物	5,747	1,317	4,430	機械及び装置	4	3	1	合計	5,750	1,320	4,430	1年内	262	1年超	3,274	合計	3,536	支払リース料	374	減価償却費相当額	265	支払利息相当額	53	1年内	15,331	1年超	12,433	合計	27,765
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																													
建物	5,747	1,102	4,645																																																													
機械及び装置	253	138	115																																																													
合計	6,000	1,240	4,759																																																													
1年内	337																																																															
1年超	3,580																																																															
合計	3,917																																																															
支払リース料	552																																																															
減価償却費相当額	347																																																															
支払利息相当額	126																																																															
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																													
建物	5,747	1,317	4,430																																																													
機械及び装置	4	3	1																																																													
合計	5,750	1,320	4,430																																																													
1年内	262																																																															
1年超	3,274																																																															
合計	3,536																																																															
支払リース料	374																																																															
減価償却費相当額	265																																																															
支払利息相当額	53																																																															
1年内	15,331																																																															
1年超	12,433																																																															
合計	27,765																																																															
2 オペレーティング・リース取引	<p>未経過リース料 (百万円)</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>17,644</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>28,175</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>45,819</td> </tr> </table>	1年内	17,644	1年超	28,175	合計	45,819	<p>未経過リース料 (百万円)</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>15,331</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>12,433</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,765</td> </tr> </table>	1年内	15,331	1年超	12,433	合計	27,765																																																		
1年内	17,644																																																															
1年超	28,175																																																															
合計	45,819																																																															
1年内	15,331																																																															
1年超	12,433																																																															
合計	27,765																																																															

有価証券関係

当事業年度および前事業年度において子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

重要な後発事象

当社は、平成21年4月27日開催の取締役会において、㈱ルネサス テクノロジとの間で、当社と同社の経営統合に向けた協議の開始について基本合意することを決議し、同日付で覚書を締結しました。

世界の半導体市場においては、製品の性能、構成、価格、品質等の様々な点で激しい競争が繰り広げられており、半導体企業各社はこうした事業環境に迅速に対応していくことが迫られています。このような状況のもと、当社は、その経営基盤と技術力をより一層強固なものとし、顧客満足のさらなる向上を通じて企業価値の増大を図ることを目指し、平成22年4月を目処に㈱ルネサステクノロジと経営統合することについて協議を開始すること、経営統合後の会社は株式市場への上場維持を基本とすること等で基本合意しました。

本経営統合の詳細条件については、平成21年7月を目処に正式契約を締結する方向で、今後、関係当事者間で協議してまいります。なお、本経営統合は、別途両社の株主総会の承認と関係当局の許認可等が得られることを条件として実施される予定です。

なお、本経営統合の相手方である㈱ルネサス テクノロジの概要(平成21年3月31日現在)は、次のとおりです。

- ①商号：㈱ルネサス テクノロジ
- ②事業内容：システムLSI、ディスクリート半導体およびメモリ製品の開発
設計、製造、販売およびサービスの提供
- ③本店所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番2号
- ④設立年月日：平成15年4月1日
- ⑤資本金：77,000百万円
- ⑥株主構成：㈱日立製作所（55%）、三菱電機㈱（45%）

平成21年3月期 連結決算概要

【連結会計年度】（平成20年4月1日から平成21年3月31日）

	平成20年3月期 前連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		平成21年3月期 当連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		前期比 増(減)	
	金額	率	金額	率	金額	率
売上高	6,877	100.0	5,465	100.0	△1,413	△20.5
半導体売上高	6,533		5,217		△1,315	△20.1
営業損益	51	0.7	△684	△12.5	△734	—
税引前損益	△33	△0.5	△893	△16.3	△861	—
当期純損益	△160	△2.3	△826	△15.1	△666	—
1株当たり当期純損益	円		円		円	%
基本的	△129.52		△669.04		△539.52	—
希薄化後	△129.52		△669.04		△539.52	—

設備投資額	561	億円	566	億円	4	億円	0.8	%
減価償却費等	751		673		△77		△10.3	
研究開発費	1,123		1,104		△19		△1.7	
米ドル為替レート(円)	116	円	101	円				
ユーロ為替レート(円)	161	円	146	円				

【第4四半期連結会計期間】（平成21年1月1日から平成21年3月31日の3か月間）

	平成20年3月期 前第4四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		平成21年3月期 当第4四半期連結会計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)		前年同期比 増(減)	
	金額	率	金額	率	金額	率
売上高	1,660	100.0	855	100.0	△804	△48.5
半導体売上高	1,554		807		△747	△48.1
営業損益	2	0.1	△533	△62.3	△536	—
税引前損益	△67	△4.1	△692	△80.9	△625	—
四半期純損益	△120	△7.2	△608	△71.1	△488	—
1株当たり四半期純損益	円		円		円	%
基本的	△97.39		△492.47		△395.08	—
希薄化後	△97.39		△492.47		△395.08	—

設備投資額	181	億円	171	億円	△10	億円	△5.6	%
減価償却費等	193		170		△23		△12.0	
研究開発費	246		269		24		9.6	
米ドル為替レート(円)	109	円	91	円				
ユーロ為替レート(円)	160	円	120	円				

	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)		当連結会計年度末 (平成21年3月31日)		前期末比 増(減)	
	金額	率	金額	率	金額	率
総資産	6,163	億円	4,825	億円	△1,338	△21.7
株主資本	2,271		1,281		△990	△43.6

従業員数	23,110	人	22,476	人	△634	△2.7	%
------	--------	---	--------	---	------	------	---

(注) ①億円未満を四捨五入して表示しております。

②当社の連結決算は「米国会計基準」に準拠しておりますが、営業損益は「売上高」から「売上原価」、「研究開発費」および「販売費および一般管理費」を差し引いたものを表示しております。

③1株当たり当期純損益および1株当たり四半期純損益は、米国財務会計基準書第128号「1株当たり利益」に基づいて算出しております。

④株主資本の金額は、「米国会計基準」に基づいて表示しております。

⑤設備投資額は、有形固定資産(ソフトウェアを除く)取得額を表示しております。

〔将来予測に関する注意〕

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下NECエレクトロニクスと総称します。）の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてNECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因があります。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

問合せ先 NECエレクトロニクス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

<報道関係> 猪熊／楓 TEL (044) 435-1676(直通)
<IR関係> 覚知／林 TEL (044) 435-1664(直通)